

# 半导体新闻周报

汇报时间：2025.11.28

# 目录

一. 特斯拉马斯克宣布AI5芯片设计即将完成, AI6芯片研发启动.....	3
二. 中科飞测首台晶圆平坦度测量设备出货HBM客户端.....	5
三. 长鑫存储发布DDR5内存新品 最高速率达8000Mbps.....	7
四. 投资10亿元, 亚芯微电子芯片封装测试基地项目进入冲刺阶段.....	9
五. 存储超级周期来袭, 得瑞领新以PCIe 5.0锚定AI存力赛道.....	10
六. 工业和信息化部: 将从三方面推动集成电路产业高质量发展.....	12
七. 高端集成电路及电子元件专用纳米功能材料项目, 落户大连! .....	13
八. AI教父与创新领袖领航, 宇树, 云天励飞等中国AI+机器人科技“天团”香江集结, 开启出海新篇章.....	15
九. 开放创芯, 成就未来——ICCAD-Expo 2025成功举办! .....	16
一〇. 日本Rapidus计划2029年生产1.4纳米芯片.....	17

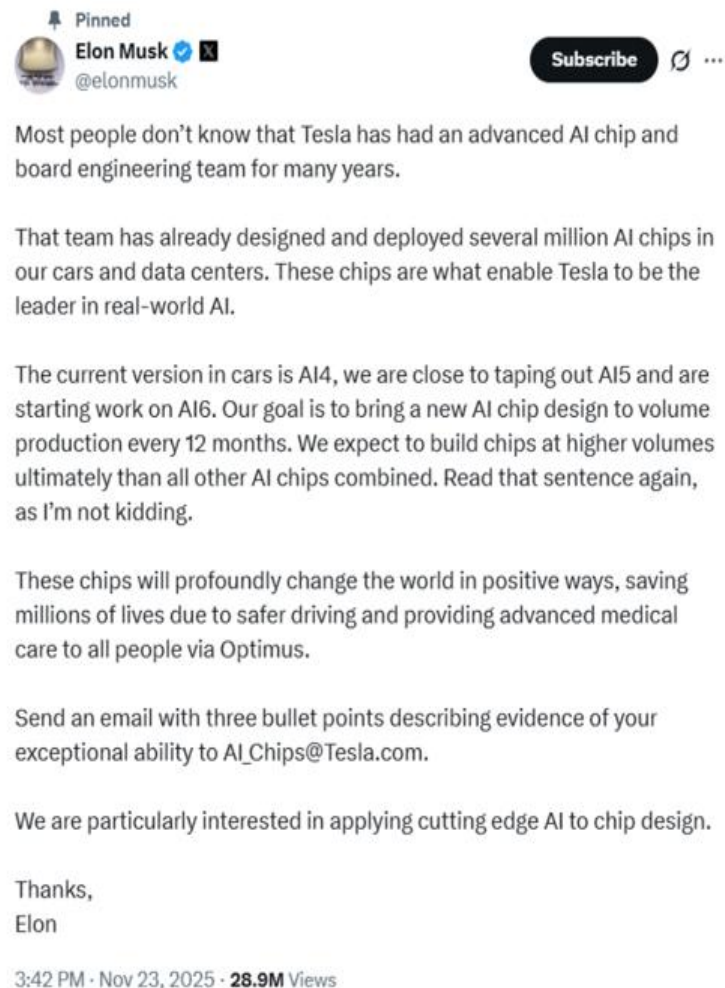
# ①特斯拉马斯克宣布AI5芯片设计即将完成，AI6芯片研发启动

2025. 11. 24

**特斯拉**首席执行官埃隆·马斯克日前在社交平台X上宣布，特斯拉即将完成自研AI5芯片的设计定案，同时已启动下一代AI6芯片的研发工作。AI5芯片的设计评审已通过，算力达2000-2500 TOPS，是目前AI4芯片的5倍，具备支持复杂无监督自动驾驶算法的能力，推理性能相比现有芯片提升约50倍。

据悉，AI5芯片计划于2026年完成小规模工程样品试制，2027年进入全面量产阶段，满足乘用车及数据中心算力需求。AI6芯片研发正积极开展，未来由三星位于德克萨斯州的新工厂承担量产，该合作协议价值达165亿美元，体现了三星代工技术的复苏及其生产能力优势。

特斯拉拥有一支世界级的AI芯片研发团队，已累计部署数百万颗自研芯片，驱动自动驾驶系统和数据中心计算，形成独特的垂直整合技术生态。马斯克强调，随着AI芯片算力的不断提升，自动驾驶安全性能将达到人类驾驶10倍，预期每年可避免数百万起交通事故。



- 特斯拉
- Tesla Inc.
- 成立时间：2003年7月1日
- 地点：美国德克萨斯州奥斯汀市特斯拉路1号
- 官网：<https://www.tesla.cn/>
- 特斯拉（Tesla）是一家电动汽车及清洁能源行业跨国公司，总部位于美国得克萨斯州，产销电动汽车、太阳能板、及储能设备与系统解决方案。
- 2004年，埃隆·马斯克进入公司并领导了A轮融资。2010年6月，特斯拉登陆纳斯达克，成为仅有的一家在美国上市的纯电动汽车独立制造商。2017年2月，特斯拉汽车正式更名为特斯拉，截止目前，特斯拉是全球市值最高的车企。



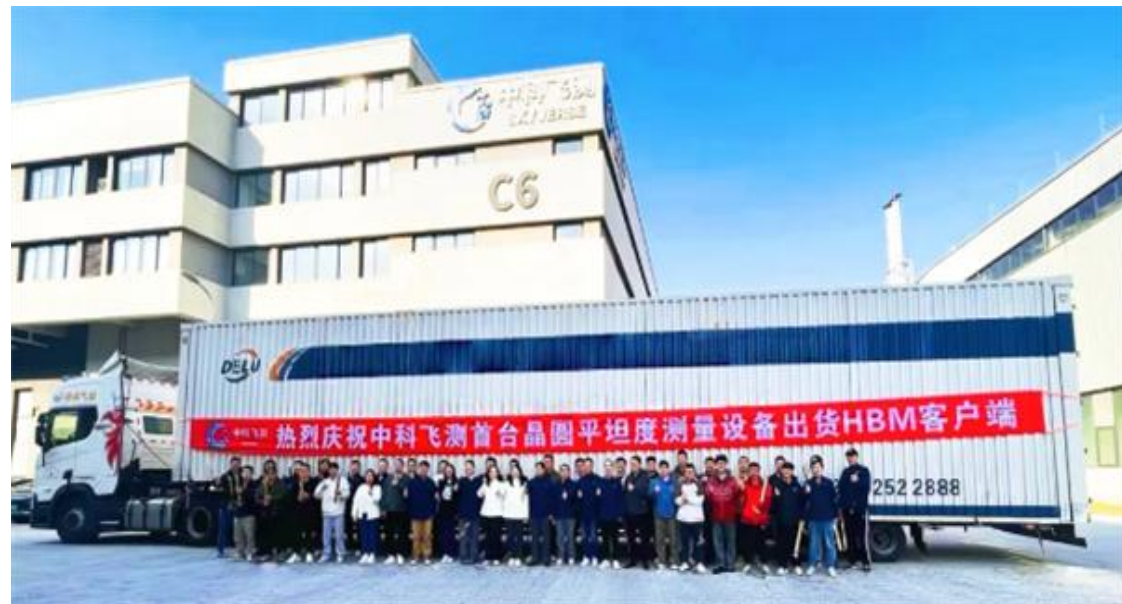


## ② 中科飞测首台晶圆平坦度测量设备出货HBM客户端

2025. 11. 24

据**中科飞测**消息，近日，中科飞测首台晶圆平坦度测量设备——GINKGOIFM-P300出货HBM客户端。GINKGOIFM-P300的成功推出，标志着我国在该领域实现了重大突破，打破了国外厂商的长期垄断，突破国内设备对超高翘曲晶圆、低反射率晶圆的量测限制，同时支持键合后晶圆、化合物半导体衬底（SiC/GaAs）的全参数检测。

据介绍，晶圆平整度测量设备，可以对有图形/无图形晶圆几何与纳米形貌的高精度量测指标进行测试，是半导体先进制造领域的核心工艺控制设备，专为图案化与非图案化晶圆的高精度几何参数检测设计。该设备以公司成熟的量测平台为基础，融合创新硬件技术与智能算法，为 IC 制造商提供从研发到量产全流程的晶圆质量监控解决方案，广泛适配 $\geq 96$  层 3D NAND、 $\leq 1\text{Xnm}$  逻辑芯片、DRAM以及HBM 等先进制程。



- 深圳中科飞测科技股份有限公司
- 成立时间：2014年12月31日
- 地点：深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301-14号101、102
- 官网：<https://www.skyverse.cn/en>
- 股东信息：

苏州翌流明光电科技有限公司	10.8%
国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）	8.64%
深圳小纳光实验室投资企业（有限合伙）	5.38%
哈承姝	4.79%
诺安成长混合型证券投资基金	3.62%
中国科学院微电子研究所	2.91%
深圳市创新投资集团有限公司	2.55%
深圳市人才创新创业一号股权投资基金（有限合伙）	2.38%
海南博林京融创业投资有限公司	2.12%
海南岭南晟业创业投资有限公司	1.97%



### ③长鑫存储发布DDR5内存新品 最高速率达8000Mbps

2025. 11. 24

11月23日，**长鑫存储**正式发布其最新DDR5产品系列：最高速率达8000Mbps，最高颗粒容量24Gb，并同步推出覆盖服务器、工作站及个人电脑全领域的七大模组产品。长鑫存储现场展示了最新DDR5系列产品，以及最高速率10667 Mbps、最高颗粒容量16Gb的最新LPDDR5X移动端内存。据称，这两大产品系列速率、容量双维度均位居业界第一梯队，标志着国产存储芯片具备与国际一线大厂同台竞技的技术实力。

资料显示，长鑫存储是中国DRAM（动态随机存取存储芯片）领域的领军企业，专注于 DRAM 的设计、研发、生产和销售，产品矩阵覆盖消费电子、服务器、AI 等多个领域。其自主研发的 DDR4 内存芯片是首颗国产 DDR4 芯片。





- 长鑫存储技术有限公司
- 成立时间：2017年11月16日
- 官网：<https://www.cxmt.com/>
- 地址：安徽省合肥市经济技术开发区翠微路6号海恒大厦630室

- 股东信息：

长鑫科技集团股份有限公司	100%	2,388,760.15663万
--------------	------	------------------

- 长鑫存储技术有限公司是一家一体化存储器制造公司，成立于2017年11月16日，注册地址位于安徽省合肥市经济技术开发区启德路799号，法定代表人吴丽影，执行董事兼总经理赵纶。公司主要从事动态随机存取存储芯片（DRAM）的设计、研发、生产和销售，技术研究和开发中心负责人为周梅生。





## ④投资10亿元，亚芯微电子芯片封装测试基地项目进入冲刺阶段

2025. 11. 24

亚芯微电子芯片封装测试基地项目是义乌引进的重点项目之一，项目聚焦功率器件、CPU等核心器件封装测试，眼下项目建设已经进入冲刺阶段。

走进亚芯微电子芯片封装测试基地项目现场，两间厂房与一间综合楼主体已全部落成。目前，工人们加紧推进土建收尾工作，接下来将全面启动洁净车间装修，为春节后试生产做好充分准备。

作为义乌引进的重点高新技术项目，基地总建筑面积83323.41平方米，总投资10亿元，规划建设厂房、行政办公楼及生活服务设施，购置专业封装测试生产设备。项目分两期推进，一期打造功率器件、电源管理、传感器等器件的封装测试生产线；二期聚焦高端集成电路封装测试，重点服务传感器、存储器、CPU等核心器件，全部达产后年生产能力约90亿片至100亿片。



## ⑤存储超级周期来袭，得瑞领新以PCIe 5.0锚定AI存力赛道

2025. 11. 24

当AI大模型与智算产业进入爆发式增长期，存储作为“算力释放的核心基石”，正迎来技术革新与场景适配的双重变革。

值此行业关键节点，**北京得瑞领新科技有限公司**（以下简称“得瑞领新”）将重磅参与MTS2026存储产业趋势研讨会，以“技术深耕 + 场景赋能”为核心，展示其全系列企业级NVMe SSD及AI存储解决方案，与全球产业链伙伴共探存储技术演进方向，共筑智算产业新生态。

作为存储行业年度盛会，本届MTS2026以“存储风云，智塑未来”为主题，汇聚全球千余家存储厂商、AI企业、终端应用及行业专家，聚焦技术演进、市场动态、产能布局等核心话题，深度解析AI时代存储产业的机遇与挑战。

当前，AI训练与推理对存储的“低时延、高吞吐、高可靠、高能效”需求呈指数级增长，传统存储架构已难以匹配智算集群的性能诉求，企业级SSD作为AI基础设施的“存力核心”，成为突破算力瓶颈、降低部署成本的关键环节。得瑞领新深耕企业级存储赛道多年，此次参展既是对自身技术实力的全面展示，更是与产业链伙伴深化协同、共解行业痛点的重要契机。



- 北京得瑞领新科技有限公司
- DERA Co., Ltd
- 成立时间：2015年6月17日
- 官网：<https://www.derastorage.com/>
- 地址：北京市海淀区安宁庄东路7号二层202
- 股东信息：

上海拜尔提克科技中心	21.32802%	3,222.0669万
深圳共创天成投资合伙企业	15.2478%	2,303.5156万
北京睿汇海纳科技产业基金	7.20949%	1,089.152万
深圳同创希望投资合伙企业	6.36058%	960.9057万
苏州国新科创二期股权投资基金合伙企业	4.78853%	723.4125万
湖南华业天成创业投资合伙企业	4.60912%	696.3085万
嘉兴考乐尔企业管理合伙企业	3.80042%	574.1369万
石家庄乾泰股权投资基金	3.71251%	560.8561万
南通中金传合股权投资合伙企业	2.55388%	385.82万 .....





## ⑥工业和信息化部：将从三方面推动集成电路产业高质量发展

2025. 11. 25

第二十二届中国国际半导体博览会（IC China 2025）11月23日在北京国家会议中心开幕，工业和信息化部总经济师高东升在致辞中表示，集成电路是信息社会的基石，是支撑现代经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业。工业和信息化部将从三方面推动集成电路产业高质量发展：

一是促进产业链协同创新。围绕集成电路设计、制造、封测、设备、材料等全产业链环节，加强资源整合和优化配置，推动集成电路产业与人工智能、新能源、智能网联汽车等战略性新兴产业深度融合，拓展应用场景，提升产业链价值。

二是持续营造良好产业环境。以企业为主体，引导产业优化布局，推动要素有序流动，市场深度融合，加强知识产权保护和运用，营造市场化、法治化、国际化的一流营商环境。

三是坚持开放合作。提升国际合作层次和水平，欢迎全球集成电路企业来华建设研发生产和运营中心，共享中国超大规模市场带来的发展机遇，支持建立区域性合作平台，深化技术标准合作，共同制定全球通用的行业标准。





## ⑦高端集成电路及电子元件专用纳米功能材料项目，落户大连！

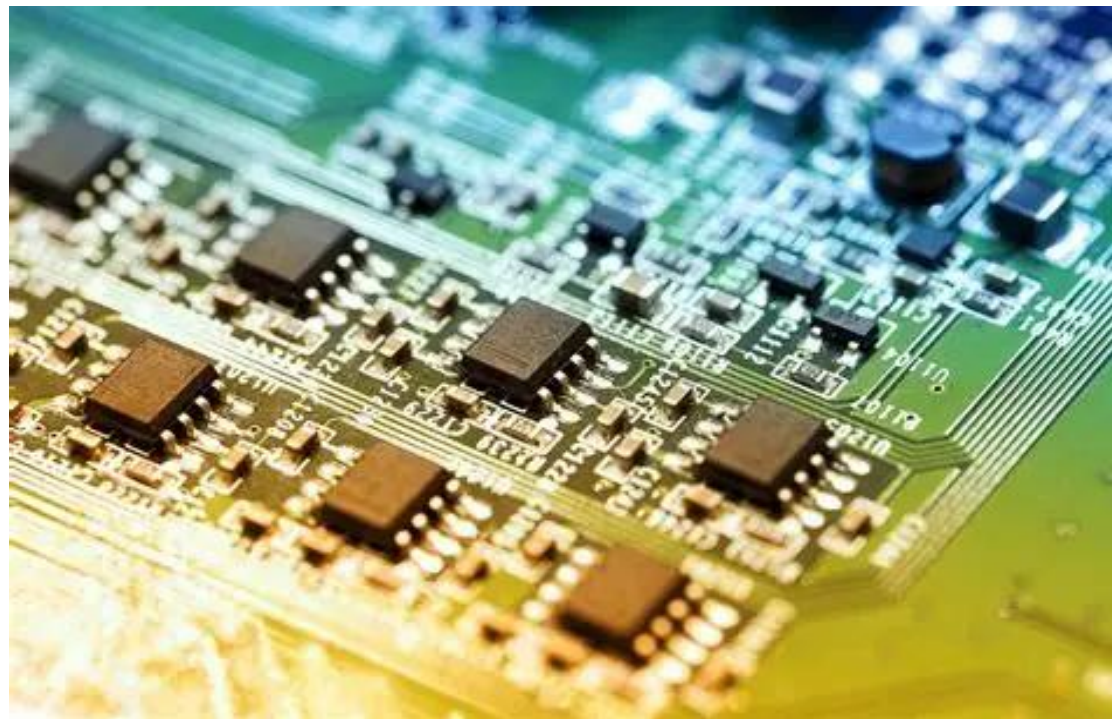
2025. 11. 25

11月21日，大连金普新区与**上海华聚金新材料科技有限公司**举行高端集成电路及电子元件专用纳米功能材料项目签约仪式。

上海华聚金新材料科技有限公司高端集成电路及电子元件专用纳米功能材料项目选址普湾经济区三十里堡临港工业区，总投资5亿元。

一期项目总投资1.3亿元，用地面积约1万平方米，将建设10条集成电路专用功能材料生产线，配套建设集成电路材料专用预处理车间、高精度提纯车间和集成电路级检测车间。项目设计年产能500吨，年产值2亿元。二期项目总投资3.7亿元，将建设高端集成电路及电子元件专用纳米功能材料智能工厂。

资料显示，上海华聚金新材料科技有限公司2022年成立，公司业务围绕有色金属合金及相关新材料展开，同时涉及进出口贸易。



- 上海华聚金新材料科技有限公司
- 成立时间：2022年3月9日
- 地址：上海市松江区明南路288弄6号1楼101室

● 股东信息：

上海阳梓贸易有限公司	32%	800万
上海和本高贸易有限公司	24%	600万
上海政铂商务咨询合伙企业（有限合伙）	24%	600万
上海昇瑞恒电子材料有限公司	20%	500万

- 上海华聚金新材料科技有限公司成立于2022年03月09日，注册地位于上海市松江区明南路288弄6号1楼101室，法定代表人为刘宇兰。经营范围包括许可项目：技术进出口；货物进出口。 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属合金制造；有色金属合金销售。

## ⑧AI教父与创新领袖领航，宇树，云天励飞等中国AI+机器人科技“天团” 香江集结，开启出海新篇章



2025. 11. 25

2025年12月2日至3日，备受瞩目的**2025 GIS全球创新展暨全球创新峰会（香港）** 将于香港亚洲国际博览馆举行。本次展会以“智汇全球 · 绿创未来”为主题，旨在打造中国科技企业出海的首发站与核心枢纽，向世界全方位展示中国科技的最新突破与硬核实力，推动全球创新资源的深度对话与产业合作。这场年末科技盛事，必将为中国乃至全球的科技创新与产业升级以及未来十年的发展带来深远的影响。

本届GIS汇聚了全球范围内的顶尖科技企业与创新团队，尤其是一批具备全球影响力的中国机器人集中亮相，将成为展会值得期待的亮点之一。

全球民用机器人领军者宇树科技、专注于AI与具身智能深度融合的智元机器人、由世界顶尖科学家领衔的赛博格机器人、国家级具身智能技术标杆云深处科技以及工业自动化“实力担当”众擎机器人将同台亮相，展现从核心部件到整机、从工业应用到消费级的全产业链实力。





## ⑨开放创芯，成就未来——ICCAD-Expo 2025成功举办！

2025. 11. 26

11月20日至21日，由成都高新发展股份有限公司、芯脉通会展策划（上海）有限公司、成都市集成电路行业协会、重庆市半导体行业协会、成都国家芯火双创基地共同主办，成都海光集成电路设计有限公司、成都华微电子科技股份有限公司支持的“**2025集成电路发展论坛（成渝）暨三十一届集成电路设计业展览会**”（简称ICCAD-Expo 2025）在成都中国西部国际博览城成功举办。

本届大会以“开放创芯，成就未来”为主题，创新设置了“1+10+1”系列活动架构，包括1场高峰论坛、10场专题论坛及1场产业展览。活动聚焦行业前沿技术、应用场景落地、产业政策与宏观趋势等关键方向，成功构建了一个融汇“技术创新链、市场生态链、应用场景链、资本赋能链”于一体的集成电路产业高端交流平台。





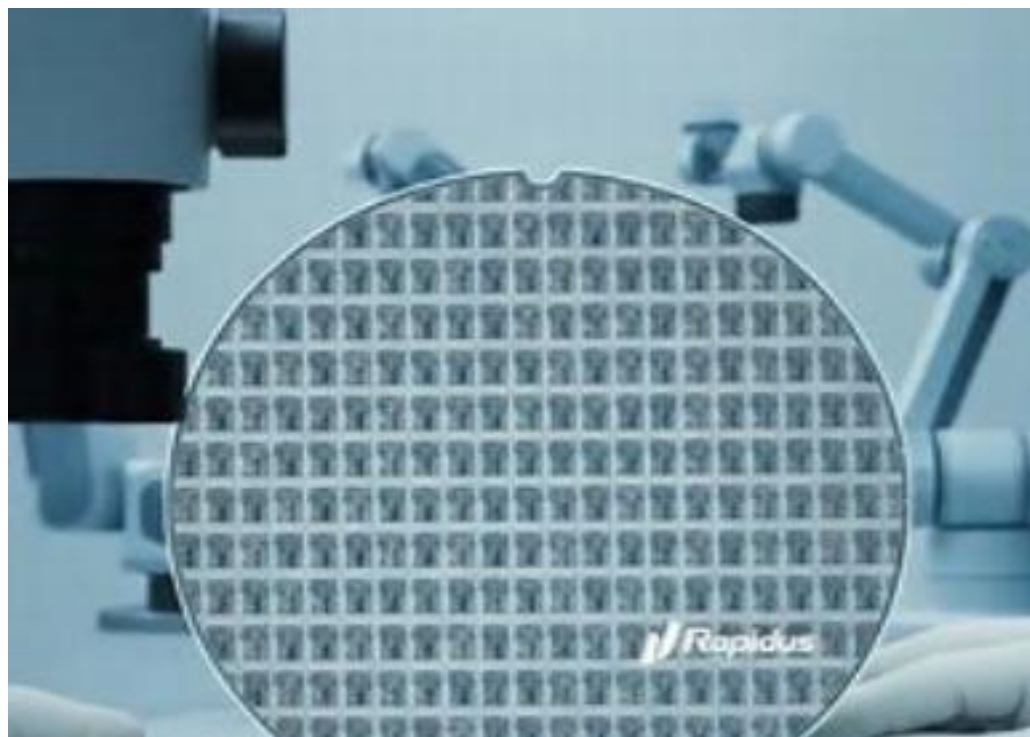
## ⑩ 日本Rapidus计划2029年生产1.4纳米芯片

2025. 11. 26

日本半导体制造商 **Rapidus** 近日宣布，计划于 2027 财年在北海道建设第二座晶圆厂，预计最快 2029 年开始生产先进的 1.4 纳米芯片。此举旨在缩小与全球芯片制造巨头台积电的差距，重建日本在先进半导体领域的战略自主能力。

据日经亚洲报道，Rapidus 第二座晶圆厂总投资预计将超过 2 万亿日元。日本政府将提供数千亿日元直接投资与补贴，剩余资金通过大型银行贷款及民营企业投资补足，贷款部分由政府提供担保。日本经济产业省（METI）已在 2025 年度拨付 8025 亿日元补助金，用于推进 2 纳米先进制程的研发与试生产。若所有援助资金全部落实，Rapidus 累计获得的政府与民间支持将接近 3 万亿日元，成为日本重返先进半导体竞争行列的国家级项目之一。

Rapidus 首座晶圆厂位于北海道千岁市，已于 2025 年 4 月启动 2 纳米芯片试制，计划 2027 年下半年正式量产，产品主要面向自动驾驶、人工智能等高端应用领域。第二座晶圆厂的建设将加速 1.4 纳米及 1 纳米芯片的研发与量产进程。



- Rapidus (Rapidus Corporation)
  - 成立时间：2022年8月10日
  - 总部地点：东京都千代田区儿司町4-1 儿岛町钻石大厦
  - 官网：<https://www.rapidus.inc/>
- 
- Rapidus是日本高端芯片公司，成立于2022年8月。  
Rapidus由软银、索尼、丰田等8家日本大公司共同筹办，公司地址位于日本东京都千代田区，董事长为东哲郎，社长兼首席执行官为小池淳义。



# Thank you

🏠 江苏省南京市江宁区双龙大道1698号景枫中心写字楼26楼01室(江宁开发区)

☎ TEL:025-84148808 ( 09:00-17:30 )

✉ E-Mail:info@bosikst.com

@ URL:https://www.bosikst.com